

<オンラインセミナー>

AI サーバー・ハイパースケールデータセンター時代の熱設計 ～データセンター冷却・AI 活用と熱モデル～

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会の諸事業に対しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、半導体構造設計技術サブコミッティ（SC）では、半導体の熱設計手法として、半導体パッケージの熱モデルの標準化及び熱モデルに使用する熱伝導率測定に関する活動を進めております。

今般、「AI サーバー・ハイパースケールデータセンター時代の熱設計 ～データセンター冷却・AI 活用と熱モデル～」と題するセミナーを企画し、データセンターの冷却ソリューション、熱設計への AI 活用事例について、特別講演としてお話しいただくとともに、半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG における取り組みなどを紹介させていただくことといたしました。

つきましては、この機会にぜひご参加いただき、各社の事業戦略・標準化戦略の立案に役立てていただくとともに、ご興味ございましたら同 SC への参画もご検討いただけますと幸いに存じます。

敬具

【開催概要】

日 時 : 2026 年 12 月 1 日（火） 13:10～17:00

開催方法 : Webex によるリモート開催

主 催 : 一般社団法人電子情報技術産業協会
半導体標準化専門委員会／半導体システムソリューション技術委員会
半導体構造設計技術サブコミッティ（SC）／熱設計技術 WG

参加費 : 無料

申込方法 : 下記サイトからお申し込みください。

<https://www.jeita.or.jp/form/custom/518/form>

お申し込み後、ご登録いただいたメールアドレス宛に Webex への参加用のミーティングリンクをご案内させていただきます。

申込期限 : 2026 年 11 月 25 日（水）までにお申し込みください。

プログラム：

時間	内容
13:10 - 13:20	開会挨拶・趣旨説明
	西 剛伺 半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG 主査
13:20 - 13:40	経済産業省様ご講演
	芝崎 聡一郎 氏 経済産業省 イノベーション・環境局 国際電気標準課 課長補佐（電気・電子・情報担当）
13:40 - 14:00	チップレットソリューション WG の紹介
	佐藤 賢央 チップレットソリューション WG 主査
14:00 - 14:50	<特別講演 1> データセンター熱対策の現状と今後の展望について
	井戸本 博樹 氏 東亜電気工業株式会社 営業開発本部 冷却システム部
14:50 - 15:20	熱設計技術 WG 活動紹介
	西 剛伺、篠田 卓也 半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG 委員
15:20 - 15:40	休憩
15:40 - 16:30	<特別講演 2> 生成 AI×Modelica で始める熱設計
	藤田 哲也 氏 図研テック株式会社 上級技術監督
16:30 - 16:50	熱設計技術 WG ・国プロ活動紹介 2
	羽鳥 仁人、武井 春樹 半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG 委員
16:50 - 17:00	閉会挨拶
	西 剛伺 半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG 主査

※プログラムは、都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

■運営事務局・各種お問合せ先

一般社団法人電子情報技術産業協会

事業推進部 担当：岩淵・大森

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1 丁目 1 番 3 号 大手センタービル 4 階

E-mail : device3@jeita.or.jp

■個人情報保護について

※お申込みいただいた皆様の個人情報は、本セミナーの受付をはじめ、JEITA 主催セミナーのご案内、セミナーアンケートでの質疑回答のために使用いたします。

これらの目的以外で使用することはございません。

※JEITA の個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。

<https://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>

以 上